### PATENT COOPERATION TREATY

## **PCT**

# TRANSLATION INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 11720p		FOR FURTHER ACTIO	N	See Form PCT/IPEA/416
International application No.		International filing date (day	/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/DE2005/000618		07.04.2005		07.04.2004
International Patent	Classification (IPC) or nation	onal classification and IPC		I
H01L21/6	2			
Applicant X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG				
		ninary examination report, es e applicant according to Artic		nternational Preliminary Examining Authority
2. This REP	ORT consists of a total of _		_ sheets, including	this cover sheet.
3. This repor	t is also accompanied by Al	NNEXES, comprising:		
a. 🔀	(sent to the applicant and	to the International Bureau) :	a total of 2	sheets, as follows:
[	sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).			
[	sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental			
	Box.			
b	(sent to the International I	Bureau only) a total of (indica	te type and number	of electronic carrier(s))
_				, containing a sequence listing and/or tables
	related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).			
	t contains indications relation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ox No. I Basis of the			
	ox No. II Priority	F		
	,	shment of opinion with regard	Lto novelty inventi	ve step and industrial applicability
		-	to novelty, mventi	we step and medistral appreachity
		y of invention atement under Article 35(2) w	vith regard to novel	ty, inventive step or industrial applicability;
	D/L 1 ( ) .	d explanations supporting such	-	ty, invenive step of industria application,
В∙	ox No. VI Certain docu	uments cited		
В∙	ox No. VII Certain defe	ects in the international applica	ation	
В	ox No. VIII Certain obse	ervations on the international	application	
Date of submission of the demand Date			of completion of thi	s report
Name and mailing address of the IPEA/EP			rized officer	
Facsimile No.			none No.	

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/DE2005/000618

Box	k No. I	I Basis of the report	
1.		th regard to the language, this report is based on the internatio icated under this item.	nal application in the language in which it was filed, unless otherwise
		which is the language of a translation furnished for the purp international search (Rule 12.3 and 23.1(b))	
		publication of the international application (Rule 12.4	
2.	rece		report is based on (replacement sheets which have been furnished to the e referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to
	$\boxtimes$	the description:	
			as originally filed/furnished
		pages*	received by this Authority on
		pages*	received by this Authority on
	$\boxtimes$	the claims:	
		nos.	as originally filed/furnished
		nos.* <u>1-10</u>	as amended (together with any statement) under Article 19
		nos.*	received by this Authority on
		nos.*	received by this Authority on
	$\boxtimes$	the drawings:	
		sheets1/2,2/2	as originally filed/furnished
		sheets*	received by this Authority on
		sheets*	received by this Authority on
		a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplem	ental Box Relating to Sequence Listing.
3.	Ш	The amendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
		the claims, nos.	
		the drawings, sheets/figs	
		the sequence listing (specify):	
		any table(s) related to sequence listing (specify):	
4.		This report has been established as if (some of) the amend they have been considered to go beyond the disclosure as file.	ments annexed to this report and listed below had not been made, since ed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
		the description, pages	
		the claims, nos.	
		the drawings, sheets/figs	
		the sequence listing (specify):	
		any table(s) related to sequence listing (specify):	
*	If ite	tem 4 applies, some or all of those sheets may be marked "sup	

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

PCT/DE2005/000618

Box		Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
1.	Statement				
	Novelty (N)	Claims	1-6	YES	
		Claims	7-10	NO	
Inventive step (IS)		Claims		YES	
		Claims	1-6	NO	
	Industrial applicability (IA)		1-10	YES	
		Claims		NO	

- 2. Citations and explanations (Rule 70.7)
  - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 03, 28

    April 1995 (1995-04-28)-& JP 06 34940 A (HITACHI

    LTD), 22 December 1994 (1994-12-22)
  - The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 7-10 is not novel within the meaning of PCT Article 33(2).
  - 1.1 With regard to claim 7, D1 discloses (paragraphs [0046], [0047]; figures 14, 15):

Method for producing dielectrically isolating trenches (17) with rounded edges of active silicon layer regions at a or in the respective transition to a buried insulation layer (2) of an SOI structure,

wherein after the etching of at least one of the isolating trenches (17), an isotropic etch of the buried insulation layer (2) is performed, giving rise to undercut zones (U) in the buried insulation layer (2);

and wherein a thermal oxidation for producing an

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement insulating layer (4) on the vertical walls of the isolation trench (17), and at surfaces of the undercut zones (U), is subsequently performed, for forming rounded edges of the insulating layers (4) over the edges in the transition regions without rounding of upper trench edges.

Therefore, independent claim 7 is not novel.

1.2 With regard to claim 8, D1 furthermore discloses (paragraph [0046]):

The buried insulation layer is an SiO<sub>2</sub> layer.

1.3 With regard to claim 9, D1 further discloses (figure 14):

during the isotropic etch, a material removal at the respective two sidewalls leads to no rounding at upper and lower edges of the trench (17) and is practically zero.

1.4 With regard to claim 10, D1 discloses (figure 15):

SOI wafer comprising at least one, preferably a plurality of dielectrically isolating trenches (17) with rounded edges of active silicon layer regions adjacent to the trench - at a respective transition region to a buried insulation layer (2).

2 The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

PCT Article 33(3).

Box No. V

citations and explanations supporting such statement
subject matter of claims 1-6 does not involve an
inventive step within the meaning of

2.1 Document D1 discloses (paragraphs [0046, 0047];
 figures 14, 15):

Method for fabricating, forming or producing at least one dielectrically isolating trench (17) with rounded edges of active silicon layer regions (3) - adjacent to the trench - at a respective transition region to a buried insulation layer (2) of an SOI structure, wherein the method comprises:

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

performing an etching process comprising two steps, wherein

- in the first step of the etching process, the trench (17) is etched as far as the insulation layer (2);
- in the second step of the etching process, undercut zones (U) are formed at (both) sidewalls of the trench (17) by means of an isotropic etch of part of the insulation layer (2); a thermal oxidation of surfaces of the trench (17)

and of the undercut zones (U) is effected after the etching process.

Claim 1 contains the following further feature:

wherein the second step is controlled in such a way that a residual thickness of the buried insulation layer corresponds to half of the initial thickness

International application No.
PCT/DE2005/000618

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

of the buried insulation layer;

In D1, too, the second step is controlled in such a way that a residual thickness of the buried insulation layer corresponds to a fraction of the initial thickness of the buried insulation layer. In figure 14, said fraction appears to be approximately half, as originally specified in the application. Nowhere does the application explain why the thickness of the buried insulation layer should correspond to half of the initial thickness of the buried insulation layer. This feature, then, cannot be regarded as inventive.

2.2 Dependent claims 2-6 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for inventive step.

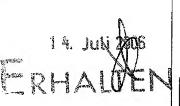
#### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

LEONHARD, Reimund Leonhard Olgemoeller Fricke Postfach 10 09 62 80083 Muenchen ALLEMAGNE



## PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN BERICHTS ZUR PATENTIERBARKEIT

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

12.07.2006

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

Internationales Aktenzeichen

11720p

Internationales Anmeldedatum (TagMonatUahr)

PCT/DE2005/000618 07.04.2005

WICHTIGE MITTEILUNG

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07.04.2004

Anmelder

X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG et al

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

**)** 

Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 Bevollmächtigter Bediensteter

Hopwood, S

Tel. +49 89 2399-2429



#### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts					
11720p	WEITERES VORGE	HEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded	atum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/DE2005/000618	07.04.2005		07.04.2004		
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. H01L21/762					
Anmelder X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG et al					
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>					
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	nt 6 Blätter einschließlich	n dieses Deckblatts.			
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	LAGEN bei; diese umfas:	sen			
a. 🛛 (an den Anmelder und das	Internationale Büro gesa	<i>ındt)</i> insgesamt 2 Bläti	ter; dabei handelt es sich um		
zugrunde liegen, und/c	Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Gründen nach Auffass	tter ersetzen, die aber au ung der Behörde eine Än Jung in der ursprünglich e	derung enthalten, die i	inkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der hinausgeht.		
b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:				
☐ Feld Nr. I Grundlage des I	Berichts				
☐ Feld Nr. II Priorität					
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens über h	Veuheit, erfinderische	l'ätigkeit und gewerbliche		
	eitlichkeit der Erfindung				
			eit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung		
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Män	gel der internationalen An	meldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	erkungen zur internationa	ilen Anmeldung			
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung dieses Berichts			
07.12.2005		12.07.2006			
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde	onalen vorläufigen E	Bevollmächtigter Bedienst	eter		
Europäisches Patentamt D-80298 München		Kenevey, K			
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52368 Fax: +49 89 2399 - 4465		el. +49 89 2399-7171	To the sound a standard of the sound a standard of the sound of the so		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000618

	Fel	ld Nr. I Grundlage de	s Berichts	
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf			
	der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.			
		es sich um die Sprach internationale Rech Veröffentlichung de	internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der e der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: erche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) er internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) ufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))	
2.	<ol> <li>Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die de Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berich "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</li> </ol>			
	Bes	schreibung, Seiten		
	1-8		in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	Ansprüche, Nr.			
	1-1	0	in der nach Artiket 19 geänderten Fassung (ggf. mit einer Erklärung)	
	Zeichnungen, Blätter			
	1/2,	2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	□ Sec	einem Sequenzprotoko quenzprotokoll	oll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das	
3.		<ul> <li>☐ Beschreibung: Seite</li> <li>☐ Ansprüche: Nr.</li> <li>☐ Zeichnungen: Blatt/</li> <li>☐ Sequenzprotokoll (g</li> </ul>	Abb.	
4.	Auf (Re	gelisteten Änderungen effassung der Behörde übegel 70.2 c)).  Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr.  Zeichnungen: Blatt/ Sequenzprotokoll (generative) etwaige zum Seque	Abb. genaue Angaben): nzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
	* "e1	Wenn Punkt 4 zutr rsetzt" versehen w	ifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung erden.	

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000618

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-6

Nein: Ansprüche 7-10

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-6

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1995, Nr. 03, 28. April 1995 (1995-04-28)
  -& JP 06 349940 A (HITACHI LTD), 22. Dezember 1994 (1994-12-22)
- Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 7-10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
- 1.1 Bezüglich Anspruch 7, D1 offenbart (Absätze [0046], [0047]; Figuren 14, 15):

Verfahren zur Erzeugung von dielektrischen isolierenden Gräben (17) mit abgerundeten Kanten aktiver Siliziumschichtbereiche an einem oder im jeweiligen Übergang zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2) einer SOI-Struktur, wobei nach der Ätzung zumindest eines der Isoliergraben (17) eine isotrope Ätzung der vergrabenen Isolationsschicht (2) vorgenommen wird, bei der unterätzte Gebiete (U) in der vergrabenen Isolationsschicht (2) entstehen; und wobei anschliessend eine thermische Oxidation zur Erzeugung einer isolierenden Schicht (4) auf den vertikalen Wänden des Isolationsgrabens (17), und an Oberflächen der unterätzten Gebiete (U) vorgenommen wird, zur Bildung abgerundeter Kanten der isolierenden Schichten (4) über den Kanten in den Übergangsbereichen ohne Verrundung oberer Grabenkanten.

Daher ist unabhängiger Anspruch 7 nicht neu.

1.2 Bezüglich Anspruch 8, D1 offenbart weiter (Absatz [0046]):

Die vergrabene Isolationsschicht ist eine SiO<sub>2</sub>-Schicht.

1.3 Bezüglich Anspruch 9, D1 offenbart weiter (Figur 14):

während der isotropen Ätzung ein Materialabtrag an den jeweils beiden

Seitenwänden führt zu keiner Verrundung an oberen und unteren Kanten des Grabens (17) und ist praktisch Null.

1.4 Bezüglich Anspruch 10, D1 offenbart (Figur 15):

SOI Wafer mit zumindest einem, bevorzugt mehreren dielektrisch isolierenden Gräben (17) mit abgerundeten Kanten von - dem Graben benachbarten - aktiven Siliziumschichtbereichen an einem jeweiligen Übergangsbereich zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2).

- Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-6 nicht auf einer erfinderischen T\u00e4tigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.
- 2.1 Dokument D1 offenbart (Absätze [0046], [0047]; Figuren 14, 15):

Verfahren zum Herstellen, Bilden oder Erzeugen zumindest eines dielektrisch isolierenden Grabens (17) mit abgerundeten Kanten von - dem Graben benachbarten - aktiven Siliziumschichtbereichen (3) an einem jeweiligen Übergangsbereich zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2) einer SOI-Struktur, wobei das Verfahren umfasst: Ausführen eines Ätzprozesses, der aus zwei Schritten besteht, wobei

- im ersten Schritt des Ätzprozesses der Graben (17) bis zur Isolationsschicht (2) geätzt wird;
- im zweiten Schritt des Ätzprozesses durch ein isotropes Ätzen eines Teils der Isolationsschicht (2) unterätzte Gebiete (U) an (beiden) Seitenwänden des Grabens (17) gebildet werden;

nach dem Äzprozess ein thermisches Oxidieren von Oberflächen des Grabens (17) und der unterätzten Gebiete (U) erfolgt.

Anspruch 1 enthält das weitere Merkmal:

wobei der zweite Schritt so gesteuert wird, dass eine verbleibende Dicke der vergrabenen Isolationsschicht der Hälfte der Anfangsdicke der vergrabenen Isolationsschicht entspricht;

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000618

Auch in D1 wird der zweite Schritt so gesteuert, dass eine verbleibende Dicke der vergrabenen Isolationsschicht einem Bruch der Anfangsdicke der vergrabenen Isolationsschicht entspricht. Im Figur 14 erscheint dieser Bruch etwa die Hälfte zu sein, wie ursprünglich in der Anmeldung angegeben. Nirgendwo erklärt die Anmeldung warum die Dicke der vergrabenen Isolationsschicht der Hälfte der Anfangsdicke der vergrabenen Isolationsschicht entsprechen sollte. Nun kann dieses Merkmal nicht als erfinderisch betrachtet werden.

2.2 Die abhängigen Ansprüche 2-6 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen.